

1. 사전등록

- 등록기간: 2023년 **9월 15일(금)**까지
- 등록방법: 학회 홈페이지를 통하여 사전등록 후 등록비 결제
- 결제방법
 - 계좌이체: 기업은행 208-017491-04-027
(예금주: (사)한국전자파학회)
 - 카드결제: 학회 홈페이지에서 카드결제 가능 (비회원 포함)
- ※ 계산서를 신청하시면 기재하신 이메일 주소로 전자계산서가 발송됩니다. (계좌이체 및 현금 결제 시에만 발급 가능)
- ※ 사전등록 시 결제까지 완료한 자에 한하여 사전등록을 인정함을 양지바랍니다.

2. 현장 등록

- 2023년 9월 22일(금) 09:30 ~ 17:00
- 장소: 양재aT센터 4층 로비

3. 등록비

구분	사전 등록	현장 등록
일반	200,000 원	230,000 원
학생	150,000 원	170,000 원

4. 문의처

- 한국전자파학회(www.kiees.or.kr) 사무국 노서연 과장
TEL: 02-337-9666(내선2), FAX: 02-6390-7550
E-Mail: synoh@kiees.or.kr
- 고속 인터커넥트 및 패키징 연구회 간사 광운대학교 송익환 교수
TEL: 02-940-5513, E-Mail: esong@kw.ac.kr
- 고속 인터커넥트 및 패키징 연구회 위원장 동국대학교 한기진 교수
TEL: 02-2260-3349, E-Mail: kjhan@dongguk.edu

aT센터 4층 창조룸 I

- 주소: 서울특별시 서초구 강남대로 27 (양재동 232 aT센터)
- 홈페이지: <https://www.at.or.kr/contents/acko331100/view.action>



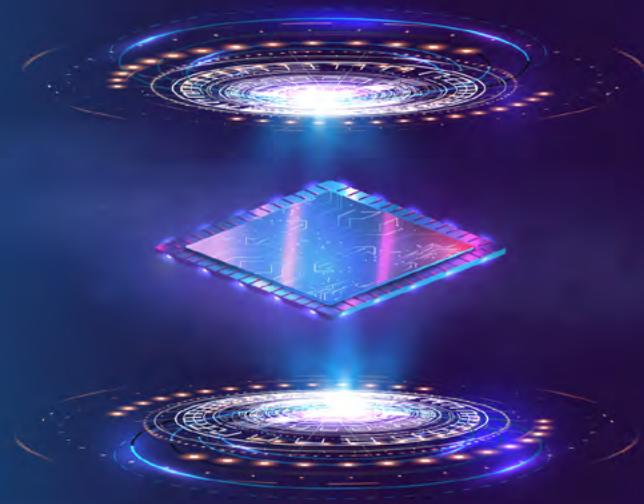
교통편 안내

- ▶ 지하철을 이용하실 경우
신분당선 "양재시민의 숲"역 → 4번출구
: 신분당선 "양재시민의 숲"역에서 하차 후 4번 출구로 나오셔서, 약 50m 직진하면 aT센터
- ▶ 버스를 이용하실 경우
간선버스 (파랑): 140, 405, 407, 408, 421, 440, 441, 462, 470, 471
지선버스 (초록): 4432
광역버스 (빨강): 9404, 9408, 9500, 9501
- ▶ 강남 고속버스터미널에서 오는 방법
강남 고속버스터미널에서 간선버스 462번 탑승 (약 7.06km 버스로 이동, 버스정류장 11개)
→ aT센터 정류장 하차
- ▶ 동서울 버스터미널에서 오는 방법
동서울버스터미널 2호선 강변역에서 강남역방향 지하철 탑승 → 2호선 강남역에서 하차 → 강남역에서 140, 407, 408, 421, 440, 441, 462, 470, 471 탑승 후 aT센터 하차

- ※ 1일주차권(24시간) 구매 가능(36,000원 개별 부담)
- ※ 시간주차(1시간) 구매는 4,200원(개별 부담)
- ※ 주차비용은 개별 부담이므로 가급적 대중교통 이용을 권장드립니다.

2023

고속 인터커넥트 및 패키지 설계 워크숍



[일시] 2023년 9월 22일(금) 09:30 ~ 17:30

[장소] 양재aT센터 4층 창조룸 I

[주최] 한국전자파학회

[주관] 고속 인터커넥트 및 패키징 연구회

[협찬] (주)원인텍, (주)이맥테크, 조인셋(주), 하나마이크론(주), (주)휴원

반도체 패키징은 전공정에서 제작된 소자를 보호하고 데이터 송수신과 전력 공급을 위해 외부 소자 및 시스템과 연결하는 반도체 후공정의 핵심 기술입니다. 반도체 미세공정의 한계가 예측되는 한편 다양한 칩들로 구성된 시스템의 성능지표가 더욱 중요해짐에 따라 과거 반도체 기술의 보조 분야로만 인식되어 온 패키지 기술에 대한 관심이 어느 때보다 높아지고 있습니다. 특히 높은 데이터 대역폭과 저전력 요건이 필수적인 최신 패키징에서 전자파 공학에 기반을 둔 전기적 설계는 인공지능 반도체 등 시스템 반도체 개발의 성패를 좌우하고 있습니다.

패키징 분야에서의 새로운 추세에 대응하고 국내 패키지 설계 분야의 경쟁력을 확보하는데 일조하기 위해, 한국전자파학회 산하 고속 인터커넥트 및 패키징 연구회는 올해부터 ‘고속 인터커넥트 및 패키지 설계 워크숍’을 개최합니다.

이번 워크숍에서는 인터커넥트 및 패키징 설계 분야의 연구개발을 선도하고 있는 산업체 및 학계의 전문가들을 모시고, 한 편의 기조강연과 총 여섯 편의 기술 세미나들로 프로그램을 준비하였습니다. 우선 본 연구회의 초대 위원장이신 한국과학기술원 김정호 교수님의 “챗GPT 인공지능 발전과 반도체 패키지의 미래”에 관한 기조강연은 현실로 다가온 인공지능 시대에 패키징 설계 기술의 미래를 전망하는 의미 있는 강연이 될 것으로 기대됩니다. 또한 기술 세미나에서는 패키징과 인터커넥트 기술의 최신 연구 동향, 성능 최적화 및 머신러닝 설계 기법, 차폐 및 소재 응용, 밀리미터파/테라헤르츠 무선 모듈용 패키징 등 다양하고 시의성 있는 주제들이 논의될 예정입니다.

새롭게 시작하는 ‘고속인터커넥트 및 패키지 설계 워크숍’이 앞으로 산학연 전문가 여러분의 상호 협력과 정보 교류를 돕는 패키지 설계 분야의 대표 워크숍으로 자리잡고, 이를 통해 점차 치열해지고 있는 기술 경쟁 속에서 국내 반도체 패키징 기술력이 더욱 향상되기를 기원합니다. 감사합니다.

2023년 9월 22일
한국전자파학회 회장 **육종관**
고속 인터커넥트 및 패키징 연구회 위원장 **한기진**

장소 : 양재 aT 센터 4층 창조룸		
시간	내용/제목	좌장/발표자 (소속기관)
09:30 - 17:30	등록	
10:00 - 11:30	개회식	사회 : 송익환 교수 (광운대학교)
10:00 - 10:30	개회사	한기진 교수 (동국대학교/ 고속인터커넥트 및 패키징 연구회 위원장)
	인사말	육종관 교수 (연세대학교/ 한국전자파학회 회장)
	고속인터커넥트 및 패키징 연구회 소개 및 활동보고	한기진 교수 (동국대학교/ 고속인터커넥트 및 패키징 연구회 위원장)
10:30 - 11:30	기조강연 (Keynote Speech)	좌장 : 권종화 박사 (한국전자통신연구원)
	챗GPT 인공지능 발전과 반도체 패키지의 미래	김정호 교수 (한국과학기술원)
11:30 - 13:00	점심 (Lunch)	
13:00 - 15:00	Technical Session I - 차세대 패키지 설계 기술	좌장 : 김지성 교수 (한국과학기술원)
13:00 - 13:40	차세대 반도체 패키징 기술 연구 동향	안승영 교수 (한국과학기술원)
13:40 - 14:20	최신 고성능 PKG의 PDN 성능과 Thermal 성능 최적화를 위한 방법론	박준서 박사 (삼성전자)
14:20 - 15:00	반도체 패키지를 위한 전자파 차폐 기술	박현호 교수 (수원대학교)
15:00 - 15:30	휴식 (Break)	
15:30 - 17:30	Technical Session II - 고속인터커넥트 설계 및 mmWave 패키징 기술	좌장 : 김종훈 대표 (이엠씨닥터스)
15:30 - 16:10	머신러닝을 이용한 고속 인터커넥트 설계	김소영 교수 (성균관대학교)
16:10 - 16:50	자가조립형 이방성 도전접착소재의 산업적 응용 및 고속신호전송특성	이경섭 대표 (노피온)
16:50 - 17:30	이종 packaging 기반의 밀리미터파, 테라헤르츠 무선 모듈의 난제 및 극복 전략	홍원빈 교수 (포항공과대학교)
17:30	폐회식(설문지 회수 및 경품추첨)	

2023 고속 인터커넥트 및 패키지 설계 워크숍 준비위원

준비위원장 : 한기진 교수 (동국대학교)

운영위원장 : 권종화 박사 (한국전자통신연구원)

준비위원 : 김소영 교수 (성균관대학교), 김종훈 대표 (이엠씨닥터스), 김지성 교수 (KAIST), 김진국 교수 (UNIST), 박용배 교수 (아주대학교), 박학병 수석 (삼성전자), 박현호 교수 (수원대학교), 송익환 교수 (광운대학교), 안승영 교수 (KAIST), 이경섭 대표 (노피온), 임영철 팀장 (한국전파진흥협회), 홍원빈 교수 (포항공과대학교)